

# Rivelatore a Microstrisce di silicio per JLAB12:

**consuntivo attivita' del periodo  
Giugno 2010 → Giugno 2011**

→ Meccanica (1 ... 4)

→ Camera Pulita (5 ... 8)

→ Elettronica (9 ... 13)

Per maggiori dettagli: presentazione di **Fulvio De Persio**

- 1) **Disegno della meccanica** per i Test di Incollaggio tra un Silicio "dummy" ed il relativo supporto in FR4.
- 2) **Realizzazione del prototipo** meccanico per i Test di Incollaggio.
- 3) Concezione, acquisto e assemblaggio delle varie parti per la **movimentazione meccanica "xyzθ"** per l'incollaggio.
- 4) Scelta e acquisto delle **colle** per i test.

5) **Riorganizzazione** dello spazio di lavoro in Camera Pulita (CL 10000):

- **pulizia straordinaria della camera stessa;**
- acquisto di un **Misuratore di Polveri;**
- acquisto **attrezzature.**

6) Verificata fattibilita' **impostazione della temperatura a 27 °C** in Clean Room, per le prove di incollaggio.

7) Scelta dei **Tool** opportuni per la nostra saldatrice e per il pitch da 50  $\mu\text{m}$  sulle metallizzazioni del rivelatore:

- **Filo (Al  $\varnothing=18\mu\text{m}$ );**
- **Wedge (fine pitch);**
- **Tool per il Wire Bond Strength Test.**

8) Ottimizzazione e acquisto di un **nuovo sistema ottico**, con telecamera, display e capacita' di memorizzazione delle immagini, da integrare con la saldatrice.

- 9) Completata Simulazione e ottimizzazione del layout del PCB (piano X) delle Microstrip.
- 10) Terminata la revisione finale del progetto esecutivo del PCB (piano X).
- 11) Contattate varie Ditte per le offerte relative alla realizzazione del PCB (piano X).
- 12) In corso disegno esecutivo del PCB per il piano Y.
- 13) Scelta e acquisto di alimentatori di HV per i rivelatori .

.. **Contattato con successo un gruppo ucraino**

per il lavoro di saldatura ad ultrasuoni,

da finanziare con **fondo FAI**.

... concordata la relativa richiesta con il nostro  
Direttore di Sezione